



Title of Change:	JCAP Bumping Site Change
Proposed First Ship date:	28 May 2021 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or NoorArdila.Shaharuddin@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < PCN.Support@onsemi.com >
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Affected products will be identified with marking code from new plant
Change Category:	Wafer Fab Change, Bump site change for 6" and 8" wafers. Polyamide change for 8" wafers using flow 3P2M flow in JCAP.
Change Sub-Category(s):	Material Change, Manufacturing Site Transfer

Sites Affected:

ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites
None	JCAP, China

Description and Purpose:

	Before Change Description	After Change Description
Other Changes	<ul style="list-style-type: none"> 6" and 8" wafers are processed at site B1 8" wafers that go process through 3P2M flow use polyamide I-8124ER 	<ul style="list-style-type: none"> All wafers are processed at site B2 8" wafers that go process through 3P2M flow use polyamide HD4100

Current mass production for 6" and 8" wafers are at JCAP site B1. They will all move to JCAP site B2.

Current address (site B1):

No.275 Binjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China, 214432

New address (site B2):

No.78 Changshan Road, Jiangyin, Jiangsu, China, 214433

There is no product marking change as a result of this change.

**Qualification Plan:****QV1 DEVICE NAME:** EMI4193MTTAG**RMS:** (RRF) 74552**PACKAGE:** WQFN-16

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj = Max rate Tj = 150°C for device, bias = 100% of rated V for Q 101 Rev D	<u>2016</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta =Max rate storage temp for device = 150°C	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min Ton=Toff is pkg dependent	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Temp = -65°C to +150°C; for 1000 cycles	<u>1000</u> cyc
HAST	JESD22-A110	Temp = 130°C, 85% RH, ~18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	<u>96</u> hrs
uHAST	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	<u>96</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	IR reflow at 245°C or 260°C (pkg dependant) MSL 1 at 260°C	

QV2 DEVICE NAME: EMI8133MUTAG**RMS:** (RRF) 74554**PACKAGE:** XDFN-16

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Tj = Max rate Tj = 150°C for device, bias = 100% of rated V for Q 101 Rev D	<u>2016</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta =Max rate storage temp for device = 150°C	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min Ton=Toff is pkg dependent	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Temp = -65°C to +150°C; for 1000 cycles	<u>1000</u> cyc
HAST	JESD22-A110	Temp = 130°C, 85% RH, ~18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	<u>96</u> hrs
uHAST	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	<u>96</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	IR reflow at 245°C or 260°C (pkg dependant) MSL 1 at 260°C	

QV3 DEVICE NAME: CM1230-08CP**RMS:** (RRF) 74556**PACKAGE:** WLCSP-BUMP

Test	Specification	Condition	Interval
HTRB	JESD22-A108	Ta = 150°C, bias = 100% of rated VRWM for 1008 hrs	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, Ton=Toff is pkg dependent	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Temp = -40°C to +125°C; for 1700 cycles	<u>1700</u> cyc
HAST	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 100% of rated VRWM for 96hrs	<u>96</u> hrs
uHAST	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig for 96hrs	<u>96</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	IR reflow at 260 MSL 1 @260C => NA for WLCSP => 3x reflow only. No Moisture soaking	

Estimated date for qualification completion: 12 July 2021

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
EMI2180MTTBG	EMI4193MTTAG
EMI8041BMUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8041MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8042MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8043MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8131MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8132MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8133MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8141MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8142MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8143MUTAG	EMI8133MUTAG
CM1205-08CP	CM1230-08CP
CM1230-02CP	CM1230-08CP
CM1230-08CP	CM1230-08CP
CM1230-J2CP	CM1230-08CP
CM1402-03CP	EMI4193MTTAG, EMI8133MUTAG
CM1422-03CP	EMI4193MTTAG, EMI8133MUTAG
CM1442-06CP	EMI4193MTTAG, EMI8133MUTAG
CM1442-08CP	EMI4193MTTAG, EMI8133MUTAG
CM1451-06CP	EMI4193MTTAG, EMI8133MUTAG
PACDN1408CG	CM1230-08CP

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23668X

発行日: 21 Jan 2021

変更件名:	JCAP バンピング拠点の変更	
初回出荷予定日:	28 May 2021 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < NoorArdila.Shaharuddin@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	影響を受ける製品は、新しい工場からのマーキングコードで識別されます。	
変更カテゴリ:	6 インチおよび 8 インチウエハーのウエハー工場の変更とバンブ拠点の変更。JCAP での 3P2M フローを使用した 8 インチウエハーのポリアミドの変更。	
変更サブカテゴリ:	製造拠点の移管、材料の変更	
影響を受ける拠点:		
外部製造工場 / 下請業者拠点:	なし	外部製造工場 / 下請業者拠点:
		JCAP, China
説明および目的:		
	変更前の表記	変更後の表記
その他の変更	<ul style="list-style-type: none"> 6 インチと 8 インチウエハーは、拠点 B1 で製造されます 3P2M フローを経て製造される 8 インチウエハーは、ポリアミド I-8124ER を使用します 	<ul style="list-style-type: none"> すべてのウエハーは拠点 B2 で製造されます 3P2M フローを経て製造される 8 インチウエハーは、ポリアミド HD4100 を使用します
6 インチと 8 インチウエハーの現在の量産は、JCAP の拠点 B1 で行われています。それらはすべて JCAP サイト B2 に移動します。		
現住所 (拠点 B1): No.275 Binjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China, 214432		
新住所 (拠点 B2): No.78 Changshan Road, Jiangyin, Jiangsu, China, 214433		
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。		



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23668X

発行日: 21 Jan 2021

認定計画:

デバイス名 : EMI4193MTTAGRMS : (RRF) 74552パッケージ : WQFN-16

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj = Max rate Tj = 150°C for device, bias = 100% of rated V for Q 101 Rev D	<u>2016</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta =Max rate storage temp for device = 150°C	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min Ton=Toff is pkg dependent	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Temp = -65°C to +150°C; for 1000 cycles	<u>1000</u> cyc
HAST	JESD22-A110	Temp = 130°C, 85% RH, ~18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	<u>96</u> hrs
uHAST	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	<u>96</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	IR reflow at 245°C or 260°C (pkg dependant) MSL 1 at 260°C	

デバイス名 : EMI8133MUTAGRMS : (RRF) 74554パッケージ : XDFN-16

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Tj = Max rate Tj = 150°C for device, bias = 100% of rated V for Q 101 Rev D	<u>2016</u> hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta =Max rate storage temp for device = 150°C	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min Ton=Toff is pkg dependent	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Temp = -65°C to +150°C; for 1000 cycles	<u>1000</u> cyc
HAST	JESD22-A110	Temp = 130°C, 85% RH, ~18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	<u>96</u> hrs
uHAST	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	<u>96</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	IR reflow at 245°C or 260°C (pkg dependant) MSL 1 at 260°C	

デバイス名 : CM1230-08CPRMS : (RRF) 74556パッケージ : WLCSP-BUMP

テスト	規格	条件	間隔
HTRB	JESD22-A108	Ta = 150°C, bias = 100% of rated VRWM for 1008 hrs	<u>1008</u> hrs
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, Ton=Toff is pkg dependent	<u>15000</u> cyc
TC	JESD22-A104	Temp = -40°C to +125°C; for 1700 cycles	<u>1700</u> cyc
HAST	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 100% of rated VRWM for 96hrs	<u>96</u> hrs
uHAST	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig for 96hrs	<u>96</u> hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	IR reflow at 260 MSL 1 @260C => NA for WLCSP => 3x reflow only. No Moisture soaking	

認定完了予定日 : 12 July 2021



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23668X

発行日: 21 Jan 2021

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
EMI2180MTTBG	EMI4193MTTAG
EMI8041BMUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8041MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8042MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8043MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8131MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8132MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8133MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8141MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8142MUTAG	EMI8133MUTAG
EMI8143MUTAG	EMI8133MUTAG
CM1205-08CP	CM1230-08CP
CM1230-02CP	CM1230-08CP
CM1230-08CP	CM1230-08CP
CM1230-J2CP	CM1230-08CP
CM1402-03CP	EMI4193MTTAG, EMI8133MUTAG
CM1422-03CP	EMI4193MTTAG, EMI8133MUTAG
CM1442-06CP	EMI4193MTTAG, EMI8133MUTAG
CM1442-08CP	EMI4193MTTAG, EMI8133MUTAG
CM1451-06CP	EMI4193MTTAG, EMI8133MUTAG
PACDN1408CG	CM1230-08CP